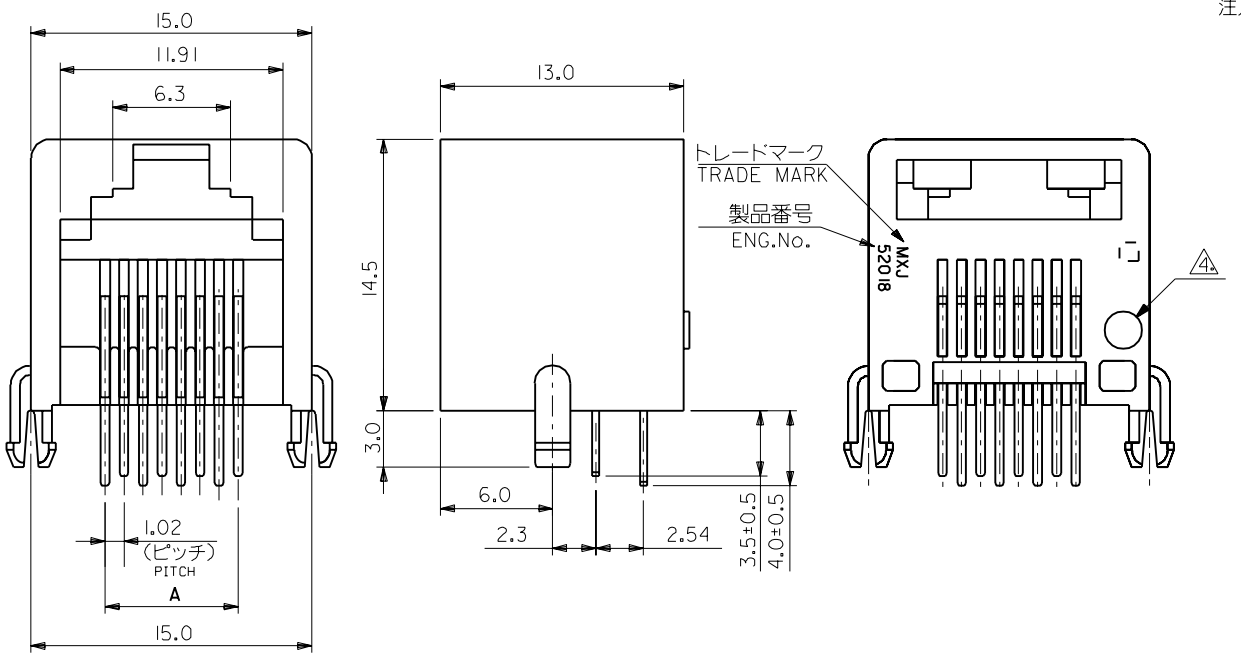
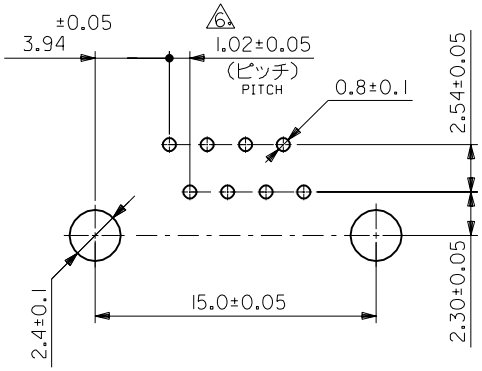
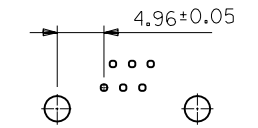


注) NOTES

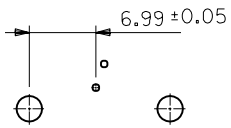
1. 材質 MATERIAL
   ハウジング：ガラス入リポリエステル UL94V-0
   HSG. :POLYESTER G.F.15% UL94V-0
   ターミナル：リン青銅
   TERM. :PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
   接点部 ：金メッキ、表参照
   CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
   半田付け部：半田メッキ 1.0μmMIN.
   SOLDER AREA : TIN-LEAD 1.0μmMIN.
   下地メッキ：ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
   UNDERPLATE : NICKEL 1.0μmMIN.
3. 推奨基板厚：t=1.6±0.05
   RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
4. 金メッキ厚標示
   COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
   黄色：0.1μmMIN. 緑色：0.38μmMIN.
   YELLOW : 0.1 μmMIN. GREEN : 0.38 μmMIN.
   オレンジ色：0.76μmMIN. 無色：1.27μmMIN.
   ORANGE : 0.76 μmMIN. UNMARKED: 1.27 μmMIN.
5. ハウジングの色は、グレイ。
   HOUSING COLOR IS GRAY.
6. 公差非累積。
   NON-ACCUMULATIVE



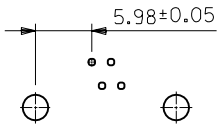
後番号 −88*5に適用
ENG NO. SUFFIX -88*5



後番号 −86*5に適用
ENG NO. SUFFIX -86*5



後番号 −82*5に適用
ENG NO. SUFFIX -82*5



後番号 −84*5に適用
ENG NO. SUFFIX -84*5

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (μmMIN.)	製品番号 ENG. No.
8	7.11	1.27	52018-8845
		0.76	-8835
		0.38	-8825
		0.1	-8815
6	5.08	1.27	-8645
4	3.05	1.27	-8445
2	1.02	1.27	52018-8245

ポジション POSITION

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
B	変更 REVISED (JC60607)	K.H H.H	'96/3/8
A	変更 REVISED (T90386)	A.M M.F	'89/12/18
0	新規作成 RELEASED	A.M M.F	'89/10/30

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL 注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH 注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
適用電線範囲 WIRE RANGE —#—
被覆外径 INS. RANGE —#—

DRAWN BY '89/10/30 A.mitake
CHK'D BY '96/3/8 H.HIRAMOTO
APP'D BY '96/3/8 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE 4 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO. —#—
ENG. NO. SD-52018-8**5
REV B
TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y

ENG. NO SD-52018-8**5
EDP NO. —#—
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
ZF3-C110-0243S5201808.DGN;1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。